

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】令和4年11月11日(2022.11.11)

【国際公開番号】WO2021/171697

【出願番号】特願2022-503085(P2022-503085)

【国際特許分類】

G 0 3 F 7/26(2006.01)

G 0 1 N 3/32(2006.01)

G 0 3 F 7/20(2006.01)

10

【F I】

G 0 3 F 7/26 5 0 1

G 0 1 N 3/32 M

G 0 3 F 7/20 5 2 1

G 0 3 F 7/20 5 0 1

【手続補正書】

【提出日】令和4年9月30日(2022.9.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

20

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

感光性樹脂組成物の樹脂膜を、 $100 \sim 2000 \text{ mJ/cm}^2$ で露光し、窒素下で $150 \sim 250$ 、 $1 \sim 3$ 時間の熱処理をして、膜厚 $10 \mu\text{m}$ 、幅 10 mm の硬化膜の短冊サンプルを作製し、

設定温度が 25 、チャック間距離が 20 mm 、試験速度が 5 mm/min 、繰り返し荷重の応力が 100 MPa になる条件で、前記短冊サンプルを繰り返し引っ張る疲労試験を行い、

30

前記疲労試験で前記短冊サンプルが破断するまでの引っ張り回数が 100 サイクル以上である、感光性樹脂組成物を選別する、感光性樹脂組成物の選別方法。

【請求項2】

前記疲労試験を 100 サイクル実施した後の短冊サンプルを、設定温度が 25 、チャック間距離が 20 mm 、試験速度が 5 mm/min の条件で引っ張る引っ張り試験における、前記短冊サンプルの破断伸び率が $10 \sim 60\%$ である、請求項1に記載の感光性樹脂組成物の選別方法。

【請求項3】

前記引っ張り試験における、前記短冊サンプルの降伏応力が $120 \sim 200 \text{ MPa}$ である、請求項2に記載の感光性樹脂組成物の選別方法。

40

【請求項4】

前記引っ張り試験における、前記短冊サンプルのヤング率が $0.5 \sim 2.8 \text{ GPa}$ である、請求項2又は3に記載の感光性樹脂組成物の選別方法。

【請求項5】

前記硬化膜のガラス転移温度が 150 以上である、請求項1～4のいずれか一項に記載の感光性樹脂組成物の選別方法。

【請求項6】

感光性樹脂組成物の樹脂膜を、 $100 \sim 2000 \text{ mJ/cm}^2$ で露光し、窒素下で $150 \sim 250$ 、 $1 \sim 3$ 時間の熱処理をして、膜厚 $10 \mu\text{m}$ 、幅 10 mm の硬化膜の短冊サ

50

ンプルを作製し、

設定温度が -55 、チャック間距離が 20 mm 、試験速度が 5 mm/min 、繰り返し荷重の応力が 120 MPa になる条件で、前記短冊サンプルを繰り返し引っ張る疲労試験を行い、

前記疲労試験で前記短冊サンプルが破断するまでの引っ張り回数が 100 サイクル以上である感光性樹脂組成物を選別する、感光性樹脂組成物の選別方法。

【請求項 7】

前記疲労試験を 100 サイクル実施した後の短冊サンプルを、設定温度が 25 、チャック間距離が 20 mm 、試験速度が 5 mm/min の条件で引っ張る引っ張り試験における、前記短冊サンプルの破断伸び率が $10 \sim 60\%$ である、請求項 6 に記載の感光性樹脂組成物の選別方法。

10

【請求項 8】

前記引っ張り試験における、前記短冊サンプルの降伏応力が $120 \sim 200\text{ MPa}$ である、請求項 7 に記載の感光性樹脂組成物の選別方法。

【請求項 9】

前記引っ張り試験における、前記短冊サンプルのヤング率が $0.5 \sim 2.8\text{ GPa}$ である、請求項 7 又は 8 に記載の感光性樹脂組成物の選別方法。

【請求項 10】

前記硬化膜のガラス転移温度が 150 以上である、請求項 7 ~ 9 のいずれか一項に記載の感光性樹脂組成物の選別方法。

20

【請求項 11】

請求項 1 ~ 10 のいずれか一項に記載の感光性樹脂組成物の選別方法で選別した感光性樹脂組成物を基板の一部又は全面に塗布及び乾燥して樹脂膜を形成する工程と、

前記樹脂膜の少なくとも一部を露光する工程と、

露光後の樹脂膜を現像してパターン樹脂膜を形成する工程と、

前記パターン樹脂膜を加熱する工程と、

を含む、パターン硬化膜の製造方法。

【請求項 12】

請求項 11 に記載のパターン硬化膜の製造方法により形成されるパターン硬化膜を、層間絶縁層又は表面保護層として備える、半導体装置の製造方法。

30

40

50